

Bergen und Wiederverwenden von sensiblen Bauteilen /1

Die aktuelle Bauteilsituation auf dem Markt sucht nach Lösungen, um schnell, kosteneffektiv und qualitativ hochwertig funktionsfähige Bauelemente wiederzuverwenden.

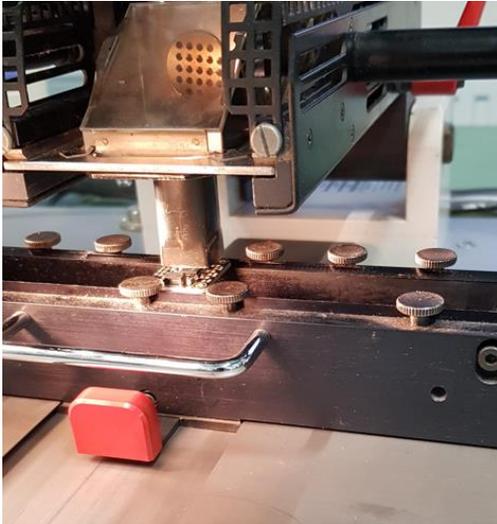
Das „Bergen von Schaltkreisen“ auf ungenutzten bzw. aussortierten Baugruppen kann Abhilfe schaffen, um Engpässe zu überbrücken.

Wir bei der eolane SysCom haben das KnowHow und die maschinellen Fähigkeiten, selbst sehr komplexe ICs von Leiterplatten abzulöten, zu reinigen und der Wiederbestückung zuzuführen.

An unserer Reworkstation mit Fineplacer gewährleisten wir sehr präzises Arbeiten mit fest einstellbaren Lötprofilen. Der Vorgang ist immer wieder reproduzierbar.



Bergen und Wiederverwenden von sensiblen Bauteilen /2



Das zu bergende Bauteil wird mit der Leiterkarte in die Auslötvorrichtung eingesetzt.
Der Auslötvorgang beginnt.

Nach dem Ablöten des Schaltkreises wird das Bauteil geprüft, anschließend u.a. im Ultraschallbad gereinigt und in unserem Temperofen behandelt.

Um eine Delamination (popcorning) im Lötprozess zu vermeiden, lagern wir die sensiblen Elemente bis zum neuen Einsatz im eigenen Temperschrank.

Das geborgene Bauteil ist nun zur Neubestückung einsatzbereit und erfüllt seinen Dienst in vielen weiteren Anwendungen.

